

ANUNCIO: Parcial N° 2

- **Fecha:** Martes 17 de Junio de 2008
- **Publicación:** Martes 3 de Junio de 2008

Temario:

Capítulo 5 – Memoria Interna

Memoria Principal Semiconductora

- Organización.
- DRAM y SRAM. Comparación.
- Tipos de ROM.
- Lógica del chip. Señales.
- Errores. Tipos de errores. Esquema de módulo de corrección.

5.2 Organización avanzada de memorias DRAM. DRAM síncrona.

Capítulo 6 – Memoria Externa

6.1. Discos magnéticos.

Características Físicas.

Parámetros para medir las prestaciones de un disco.

6.2 RAID. Descripción. Características. Aplicaciones.

Capítulo 7 – Entrada/salida. Introducción.

7.2. Módulo de E/S. Estructura.

7.3. E/S Programada (polling)

- Resumen
- Órdenes de E/S
- Instrucciones de E/S

7.4. E/S mediante interrupciones.

- Procesamiento de la Interrupción.
- Cuestiones de diseño.

7.5. Acceso directo a memoria.

- Inconvenientes de la E/S programada y con interrupciones.
- Funcionamiento DMA

Capítulo 10 – Repertorio de instrucciones: características y funciones.

10.1. Características de las instrucciones máquina.

- Elementos de una instrucción máquina.
- Representación de las instrucciones.
- Tipos de instrucciones.
- Número de direcciones.
- Diseño del repertorio de instrucciones.

10.2. Tipos de operandos. Direcciones, números, caracteres y datos lógicos.

10.4. Tipos de operaciones.

- Transferencia de datos.
- Aritméticas.
- Lógicas.

- Conversión.
- E/S.
- Control del sistema.
- Control de flujo. Instrucciones de salto y funcionamiento de la pila.

10.6. Lenguaje ensamblador.

Apéndice 10A. Pilas.

Apéndice 10B. Endian.

Capítulo 11 – Repertorio de instrucciones: modos de direccionamiento y formatos.

11.1. Direccionamiento.

- Inmediato.
- Directo.
- Indirecto.
- Registro.
- Indirecto con registro.
- Con desplazamiento.
- Pila.

11.3. Formatos de instrucciones. Longitud y asignación de los bits.